**中国工商银行软件开发中心**

**2022年度春季校园招聘公告**

软件开发中心成立于1996年6月，主要负责全行应用研发、新技术研究、技术管理、服务支持、生产运维、人才培养任务，共有员工6000余名，目前分布在珠海、广州、上海、北京、杭州、成都、西安等七个城市办公。

 **珠海本部**主要负责全中心的架构规划、标准制定和研发管理工作；主要承担对公领域的研发工作，涵盖对公基本业务、清算、客户与营销、业务运营、单证业务、人力资源等领域的研发工作；负责数字化银行、物联网、生物识别领域的技术研究及相关平台的研发工作。**广州研发部**主要承担个金、信用卡、投资理财等零售领域的研发工作以及境外特色研发工作，负责区块链技术研究及相关平台研发工作。**上海研发部**主要承担全行经营分析、监管报送、托管和养老金业务、财务管理、风险与合规管理、办公管理等领域的研发工作；负责大数据及人工智能的技术研究和相关平台研发工作。**北京研发部**主要承担网上银行、手机银行、境外核心系统的研发工作；负责互联网金融技术研究及相关平台的研发工作。**杭州研发部**主要承担普惠金融、金融市场、信贷、合作方等领域的研发工作；负责分布式技术、云技术、开放平台开发技术及相关平台的研发工作。**成都研发部**主要承担银行卡内部管理、交易型业务风险防控、综合化等领域的研发工作。**西安研发部**主要承担远程银行中心、智能客服、自助渠道、渠道管理等系统的研发工作。**应用支持部**在上海、北京办公，主要负责生产运维工作。

成立25年来，软件开发中心坚持自主研发，始终与时代同行，与全行发展共进，围绕全行改革发展和业务经营需要，先后完成了五代自主创新核心银行系统，为全球范围内超过1.91万个分支机构、900多万家公司客户、近7亿个人客户提供金融科技服务，以科技力量支持工商银行构筑综合化、国际化、信息化的经营格局和横跨六大洲的服务网络，助力工商银行成为具有全球影响力的优秀大行。软件开发中心不仅在科技手段的代际更新中打造了工商银行的核心竞争力，同时也走出了一条独具特色的金融科技创新之路，为我国银行业提供了前沿的系统建设思路和宝贵的工程实施经验。新时期，工商银行开启了数字化银行转型的新征程，软件开发中心作为数字工行建设的主力军，积极建立起数字银行、大数据、云计算、人工智能等创新实验室，深入布局前沿技术领域，目前正在全力以赴打造数字工行，建立核心业务处理系统和开放式生态系统并行驱动、金融与科技高度融合的全新生态体系，打造引领行业变革的新标杆。

**一、招聘机构**

中国工商银行软件开发中心

1. **招聘范围**

面向境内、境外高校毕业生，毕业时间为2021年1月至2022年7月。

**三、招聘岗位**（600人）

（一）专业英才计划。主要为我中心综合业务提供专业人才储备，培养办公行政、人力资源等综合管理领域相关岗位专业人才。

（二）科技菁英计划。主要为我中心甄选产品研发、用户研究、大数据研究等领域的科技专业人才。

**四、工作地点**

珠海（珠海本部）

广州（广州研发部）

上海（上海研发部、应用支持部）

北京（北京研发部、应用支持部）

杭州（杭州研发部）

成都（成都研发部）

西安（西安研发部）

**五、招聘条件**

各岗位招聘条件详见附件《中国工商银行软件开发中心2022年度春季校园招聘职位表》。

**六、注意事项**
 （一）本次招聘可通过PC端或手机移动端进行线上报名申请。

（二）招聘程序中各环节成绩仅对本次招聘有效。

（三）招聘期间，我行将通过招聘系统信息提示、手机短信或电子邮件等方式与应聘者联系，请保持通信畅通。

（四）应聘者应对申请资料信息的真实性负责。如与事实不符，我行有权取消其应聘资格，解除相关协议约定。

（五）我行从未成立或委托成立任何考试中心、命题中心等机构或类似机构，从未编辑或出版过任何校园招聘考试参考资料，从未向任何机构提供过校园招聘考试相关的资料和信息。

（六）了解更多招聘讯息及相关动态，敬请关注“中国工商银行人才招聘”微信公众号。

（七）中国工商银行对本次招聘享有最终解释权。

**七、联系方式**

1.电子邮箱（不接收简历）：

珠海本部：zhaopin@sdc.icbc.com.cn

广州研发部：gyzhp@sdc.icbc.com.cn

上海研发部：syzhp@sdc.icbc.com.cn

北京研发部：byzhp@sdc.icbc.com.cn

杭州研发部：hyzhp@sdc.icbc.com.cn

成都研发部：cyzhp@sdc.icbc.com.cn

西安研发部：xyzhp@sdc.icbc.com.cn

2.联系电话：

珠海本部：0756-3396887

广州研发部：020-83927681

上海研发部：021-28916118

北京研发部：010-82706706

杭州研发部：0571-88499665

成都研发部：028-67133137

西安研发部：029-61066277

附件：《中国工商银行软件开发中心2022年春季校园招聘岗位需求计划表》